

深圳市龙图光罩股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929号《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元后，募集资金净额为人民币55,346.25万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第010053号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	8110301080100999999	18,000.00	10.91	活期
招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755918158910888	21,743.75	184.91	活期
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529202168443	18,000.00	9.95	活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行	656901320810006		190.83	活期
合 计		57,743.75	396.60	

二、前次募集资金使用情况

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币37,628.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币577.10万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项核验，并出具了《深圳市龙图光罩股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第590003号）。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司高端半导体芯片掩模版研发中心项目无法单独核算效益。项目建设主要包括购置先进的相关设备，引进优秀研发人才，投入研发相关课题研究费用，在提升原有产品技术及生产工艺的同时，通过技术交流、独立研发、课题合作等手段，研发新产品工艺，扩大业务规模。研发中心项目的实施，将整合现有研发资源，升级研发、测试等相关软硬件设备，为公司的制造基地项目提供坚实的技术基础，从而推动公司不断向更高的工艺制程迈进，服务更广泛的客户需求，增强公司的综合实力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以及不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司未使用的募集资金余额为396.60万元，前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目及按照相关规定使用。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

（以下无正文）

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年3月24日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市龙图光罩股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：55,346.25						已累计使用募集资金总额：55,033.19				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2024 年：52,369.05				
						2025 年：2,664.14				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端半导体芯片掩模版制造基地项目	高端半导体芯片掩模版制造基地项目	55,000.00	53,346.25	53,167.93	55,000.00	53,346.25	53,167.93	-178.32	2025 年第四季度
2	高端半导体芯片掩模版研发中心项目	高端半导体芯片掩模版研发中心项目	3,320.00	2,000.00	1,865.26	3,320.00	2,000.00	1,865.26	-134.74	2025 年第四季度
3	补充流动资金项目		8,000.00							
合计			66,320.00	55,346.25	55,033.19	58,320.00	55,346.25	55,033.19	-313.06	

附表 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025 年度		
1	高端半导体芯片掩模版制造基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	高端半导体芯片掩模版研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”预计效益、内部收益率等相关项目评价指标或其他财务指标。

注 2：详见“五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明”。